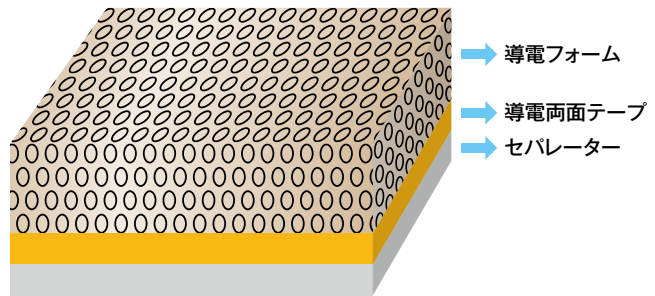


高クッション導電パッキン

フォーム内部まで均一に金属付与されたソフトな導電パッキン

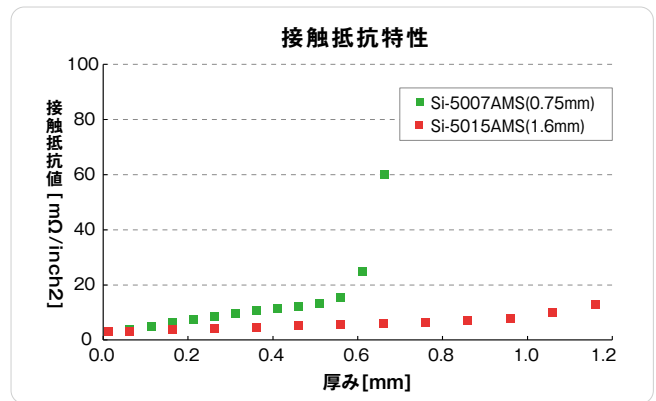
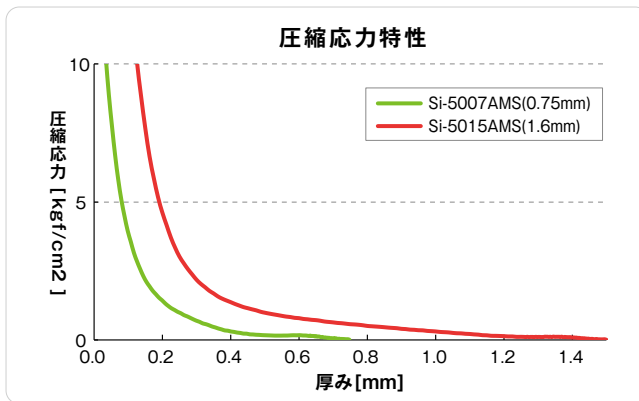
構造と特長

- ソフトな素材で、広い厚みレンジでの使用が可能
- フォーム内部まで均一に金属化され、優れたグランド性を発揮
- 様々な形状に打抜き可能
- 圧縮特性に優れる



性能

品名	Si-5007AMS	Si-5015AMS
厚み(mm)	0.75	1.6
使用厚みレンジ(mm)	0.15~0.4	0.3~1.0
接触抵抗値(mΩ/inch ²)	30	30
圧縮残留歪(%)	8	8
粘着力(N/inch)	11.5	11.5



※このデータは測定値であり、保証値ではありません。

用途

- FPCや基盤のグラウンディング
- 電磁波シールド

